

公司概況資料表

以下資料由**竝騰科技股份有限公司**及其**推薦證券商**提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：竝騰科技股份有限公司 (股票代號：7751)

董事長	王獻儀
總經理	徐嘉新
資本額	244,116,000元
輔導推薦證券商	台新綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	台新綜合證券股份有限公司 施加邦(07)537-0755 #126
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購竝騰科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	台新綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
認購日期	113年6月6日	
認購股數(股)	533,000股	200,000股
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.18%	0.82%
認購價格	185元	
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之認購價格，作為竝騰科技股份有限公司(以下簡稱竝騰或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價	

格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括
1.市場基礎法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及(2)股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；2.成本法，亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；3.收益基礎法中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，由於股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，及因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購宏騰科技股份有限公司僅就市場基礎法一本益比法進行評估。

該公司為自動化設備及半導體設備之設計及製造專業廠商，經參酌目前國內上市(櫃)同業資料，並綜合考量產業屬性與營運規模後，選擇上櫃公司萬潤科技股份有限公司(股票代號：6187)，主要從事自動化機械工程設計、加工製造、組合及電腦軟體研究開發設計及光學儀器製造等業務；上櫃公司豪勉科技股份有限公司(股票代號：6218)，主要從事半導體設備與應用材料、光電設備之銷售業務；以及上市公司辛耘企業股份有限公司(股票代號：3583)，主要從事半導體、LED、太陽能及LCD等製程機台設備之研發與製造業務，作為該公司之採樣同業。茲將其採樣同業、上市(櫃)半導體類股最近三個月(113年2月~113年4月)之本益比列示如下：

公司	113年2月	113年3月	113年4月	平均
萬潤(6187)	186.26	148.49	147.91	160.89
豪勉(6218)	24.27	47.83	59.29	43.80
辛耘(3583)	32.69	35.06	41.88	36.54
上櫃半導體業	30.77	29.77	27.45	29.33
上市半導體類	22.74	24.90	24.86	24.17

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

宏騰科技之採樣同業及上市櫃半導體業類股最近三個月平均本益比區間為14.46~160.89倍，以該公司112年度經會計師查核簽證之財務報告，其稅後淨利為160,253千元，每股盈餘為6.65元，以此每股盈餘為計算基礎，並排除極端值且以採樣同業及上市櫃半導體業類股

	<p>最近三個月平均本益比區間為24.17~43.80倍推算之本益比參考價格區間為160.73~291.27元。</p> <p>綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之本益比法，另經參酌該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量總體經濟環境因素及市場流動性風險後，本主辦輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃每股認購價格為新台幣185元，尚屬合理。</p>
--	---

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

該公司係民國83年成立，主要產品為點膠植片散熱機、AOI 檢測機及自動交換機等，依據客戶需求及市場發展趨勢，提供客製化設備開發與設計、檢測效能提升及設備整合應用等完整解決方案，其產品主要應用於半導體封測產業。該公司具備軟硬體整合優勢，自產品材料、製程、電控、軟體、機構、視覺及光學等皆為自主研發，並擁有多項專利技術，因此得以成為國際半導體封測大廠之重要研發夥伴。

該公司除提供客製化設備開發與設計、檢測效能提升及設備整合應用等完整解決方案，亦及時提供客戶維修服務與技術支援，以滿足客戶需求及提升自身競爭優勢。隨著行動裝置、高效能運算、汽車電子及物聯網等四大主要市場持續發展，加上 AI 及 HPC(高效能運算)應用崛起，帶動先進封裝製程設備需求增加，根據 IDC(國際數據資訊)研究報告，預計2023年至2028年先進封裝市場之年複合成長率將達到22%。

二、歷史沿革

年度	重要紀事
83年	創立竝騰自動化機械企業有限公司，實收資本額為500萬元。
85年	研發出 H-5000散熱片置放機。
86年	研發出 T-1520 BGA 2D 檢測機台。
87年	1.現金增資700萬元，實收資本額為1,200萬元。 2.研發出 H-6530 BGA 基板自動檢測機、T-2000捲帶印碼檢測機。
88年	研發出全球第一台 OS-7000 OPEN/SHORT 短斷路測機，以及 LC-3000 BGA 基板收放機。
89年	1.現金增資800萬元，實收資本額為2,000萬元。 2.更名為竝騰科技股份有限公司 3.研發出 HS-1000 BGA 散熱片置放機、OS-7220覆晶 O/S 測試機。
90年	研發出 HS-2400 BGA 散熱片置放機、AP-2000機版噴印機。
91年	1.現增2,176萬元及盈餘轉增資824萬元，實收資本額為5,000萬元。 2.研發出 OS-7300/OS-1100 O/S 測試機、FI-3500 BGA 3D 檢測機。
92年	1.現金增資400萬元，實收資本額為5,400萬元。 2.遷入楠梓加工出口區(楠梓科技產業園區)新廠，建坪3,764.19平方公尺。 3.盈餘轉增資2,650萬元，實收資本額為8,050萬元。 4.研發出 DS-3000植片及點膠機台、CI-2000覆晶被動元件檢測。

93年	研發出 SP-1010錫膏印刷機，並致力發展覆晶點膠系列機、非接觸式測試系列機台、研發光電檢測設備。
94年	通過 ISO 9001品質認證並致力導入專案管理制度。
95年	1.榮獲經濟部卓越小型企業創新研發計畫(SBIR)研發成果獎。 2.研發出 CV-1000 2D 視覺軟體系統、LU-1000 PBGA 入收料機、CL-1000 乾冰清洗機。
96年	研發出 SD-1000 SD Card 壓合機並致力發展3D 視覺軟體系統。
97年	研發出 BP-5100 Board To Tray 高速交換機、WB-1000 晶圓劈裂機。
98年	研發出 WB-1100晶圓劈裂機、OS-6000 O/S 測試機。
99年	1.榮獲日月光年度最佳測試解決方案供應商。 2.榮獲矽品年度傑出表現獎。 3.研發出 FI-7100 3D 視覺檢測機、OS-1210 O/S 測試機。 4.於薩摩亞投資成立億利控股有限公司。
100年	成立上海屹騰貿易有限公司。
101年	研發出 FI-7300 5S 側邊檢測機。
102年	研發出 DS-7000 PBGA 點膠植片機。
103年	1.榮獲日月光年度最佳封裝設備服務供應商。 2.研發出 SP-3000 高精度錫膏印刷。
104年	1.現金增資450萬元，實收資本額為8,500萬元。 2.研發出 WR-1000 Wafer 暗崩檢測機、DS-3070點膠植片壓合機。
105年	研發出 IP-1000 智慧包裝線、DP-7700 精密氣壓式點膠機。
106年	1.研發出 WS-1000 Wafer Stocker 晶圓自動倉儲系統。 2.設立屹騰生技股份有限公司，從事研發高經濟水產品養殖技術。
107年	1.榮獲矽品年度最佳供應商獎。 2.研發出 FI7600-3D 視覺模組、IP2000 植球系統自動化連線。
108年	1.榮獲第15屆年度十大企業金炬獎。 2.研發出 LI1000 Lid Gap Inspection 散熱片五面檢測機。
109年	1.榮獲第29屆磐石獎。 2.榮獲第20屆傑出企業及傑出領導人金鋒獎。 3.財政部頒發109年度開立統一發票績優營業人。 4.研發出 PF1000 Film Attach Machine 石墨烯貼合機。 5.成立上海屹騰科技有限公司，從事治具製造及銷售。 6.屹騰生技股份有限公司因研發效益不彰予以解散。
110年	1.盈餘轉增資8,500萬元，實收資本額為17,000萬元。 2.榮獲第24屆小巨人獎。 3.榮獲第八屆鄧白氏產業領先獎(連續五年獲獎)。 4.建置全屋頂太陽能光電系統170KW。 5.研發出 DS-3090點膠植銅片壓合機
111年	1.盈餘轉增資1,700萬元，實收資本額為18,700萬元。 2.承租鳳山廠1,711.79平方公尺作為倉儲場地之用。 3.研發出 DS-3070S 新一代點膠植片壓合機 4.研發出 FI7700-3D 全功能六面檢測機
112年	1.現金增資1,300萬元，實收資本額為20,000萬元。

	2.盈轉4,000萬元及員工酬勞轉增資411.6萬元，實收資本額為24,411.6萬元。 3.研發出 DS-3100全自動銅片線
113年	1.榮獲第7屆潛力中堅企業獎。

三、經營理念

- 培育專業技術團隊
致力於經營與管理世代人才之培育，為公司永續經營佈局。
- 成為專業半導體設備廠商
持續投入研發，以提高技術層次與競爭門檻，並為客戶提供最優良之產品。
- 技術整合差異化
將光電、機械、電控及軟體等實力整合為核心技術，以建立技術差異化。

四、未來展望

(一)短期業務發展計劃

- 1.以客戶需求為優先，建立 HTA 品牌信賴度。
- 2.配合客戶新製程之需求，以提供完整製程設備及提升設備操作穩定度。
- 3.配合半導體先進進程封裝趨勢，首先開發新產品以主導市場設備規格。
- 4.擴大精密模具核心技術應用，並持續投入電測領域。

(二)長期業務發展計劃

- 1.發展高精度、高速度及關鍵性專利技術。
- 2.持續投入雷射與光學檢測設備之發展，建立市場競爭力。
- 3.持續發展精密關鍵主製程設備，推廣先進封裝主力客戶，並強化推展中國市場。

[TOP ^](#)



主要業務項目：

主要係從事半導體自動化設備之研發、製造及銷售之研發、設計製造及銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

竑騰科技主要產品為點膠植片散熱機、AOI 檢測機及自動交換機等半導體封測設備，因機械設備組裝過程所需之零組件種類眾多，故竑騰科技主要係向協力廠商採購生產所需之零組件，經自行開發、設計組裝、電力配置、整合軟硬體及檢測後，再將設備銷售予下游半導體封測產業廠商，以供其封裝與測試使用。

上游產業	中游產業	下游產業
電子材料業 五金零件業 機械器具業 資訊軟體業 電腦設備業	機械設備製造業 自動設備控制工程業 組裝及機電整合業	半導體封測業 其他產品製造業

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額 (千元)	佔總營收 比重(%)
機台設備		點膠植片散熱	653,812	73.80
		視覺檢測		
其他		治具、零件及維修收入	232,140	26.20
合計			885,952	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年(註1)	109年(註1)	110年(註1)	111年(註1)	112年(註1)	113年截至4月份止 (自結數)(註2)
	營業收入		886,148	1,036,235	1,186,378	1,272,533	885,952
營業毛利		396,313	507,483	632,507	609,998	439,011	208,268
毛利率(%)		44.72	48.97	53.31	47.94	49.55	54.92
營業損益		244,794	322,934	353,821	309,980	190,180	121,133
營業外收入及支出		(1,105)	(20,283)	(25,429)	183,182	16,508	8,884
稅前損益		243,689	302,651	328,392	493,162	206,688	130,017
稅後損益		193,458	245,968	262,269	389,590	160,253	103,897
每股盈餘(元)		11.50	14.54	14.06	17.37	6.65	4.27
股利發放	現金股利(元)	6	10	15	10	6	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	10	1	2	-	-

註1：108~112年度財務資料係依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證。

註2：113年截至4月份止係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		108年	109年	110年	111年	112年
項目						
流動資產		1,157,579	1,068,329	1,752,509	1,700,267	1,616,541
不動產、廠房及設備		36,962	47,935	52,582	56,165	64,659
無形資產		1,708	2,053	5,243	6,336	2,875
其他資產		70,146	80,777	64,804	54,140	53,567
資產總額		1,266,395	1,199,094	1,875,138	1,816,908	1,737,642
流動負債	分配前	713,856	448,052	972,181	779,571	654,268
	分配後	764,529	533,052	1,227,181	979,571	尚未分配
非流動負債		51,918	52,722	38,675	35,325	30,349
負債總額	分配前	765,774	500,774	1,010,856	814,896	684,617
	分配後	816,447	585,774	1,265,856	1,014,896	尚未分配
股本		85,000	85,000	170,000	187,000	244,116
資本公積		6,756	6,777	6,924	6,924	81,042
保留盈餘	分配前	411,414	606,259	685,050	805,793	725,989
	分配後	360,741	521,259	430,050	605,793	尚未分配
其他權益		(414)	(416)	(385)	(267)	(450)
庫藏股票		(2,307)	(1,489)	-	-	-
非控制權益		172	2,189	2,693	2,562	2,328
股東權益 總額	分配前	500,621	698,320	864,282	1,002,012	1,053,025
	分配後	449,948	613,320	609,282	802,012	尚未分配

註1：108~111年度財務資料係依 IFRS 編製並經會計師查核簽證。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		110年	111年	112年
項目				
財務比率	毛利率(%)	53.31	47.94	49.55
	流動比率(%)	180.27	218.10	247.08
	應收帳款天數(天)	67	38	36
	存貨週轉天數(天)	265	270	351
	負債比率(%)	53.91	44.85	39.40

(註) 上述110~112年度財務資料係依 IFRS 編製並經會計師查核簽證。

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)